

证券代码：002916

证券简称：深南电路

## 深南电路股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-14

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他（_____）
参与单位名称及人员姓名（排名不分先后）	UBS AG、东吴证券、长城证券、中金公司等。
时间	2022年8月25日—8月26日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	证券事务代表：谢丹。
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>交流主要内容：</b></p> <p><b>Q1、请介绍公司2022上半年封装基板业务营收规模、毛利率同比增长的原因。</b></p> <p>2022年上半年，公司封装基板业务实现主营业务收入13.66亿元，同比增长24.78%，占公司营业总收入19.60%，封装基板业务毛利率30.27%，主要得益于无锡基板一期工厂产能爬坡扩大营收规模，摊薄单位产品固定成本，助益毛利率增长。</p> <p><b>Q2、请介绍公司无锡基板一期工厂投产情况及产品定位。</b></p> <p>公司无锡基板一期工厂于2019年6月连线投产，2020年10月实现单月盈亏平衡。主要面向存储类封装基板产品，目前已保持较高产能利用率。</p> <p><b>Q3、请介绍公司无锡基板二期工厂建设进展及产品定位。</b></p> <p>公司无锡基板二期工厂主要面向高端存储及FC-CSP封装基板，预计2022年第四季</p>

度连线投产。

**Q4、请介绍公司封装基板产品主要类型。**

公司目前量产封装基板产品均为 BT 类载板，主要包括模组类封装基板、存储类封装基板、应用处理器芯片用封装基板。使用 ABF 材料的 FC-BGA 封装基板将在现有平台基础上进行深度孵化。

**Q5、请介绍公司封装基板工厂产能利用率情况。**

受半导体下游市场增长分化影响，封装基板供需紧张的局面有所缓和，整体供求关系回归正常。目前封装基板工厂产能利用率仍保持较高水平。

**Q6、请介绍公司 PCB 业务在国内及海外通信市场的拓展情况。**

公司 PCB 业务长期深耕通信领域，覆盖各类无线侧及有线侧通信 PCB 产品。2022 年上半年，国内通信市场需求相对平缓，海外通信市场需求持续增长。公司在国内通信市场保持稳定份额的同时，持续深耕海外通信市场，海外通信业务占比有所提升。

**Q7、请介绍公司汽车电子 PCB 产品主要应用领域。**

汽车电子是公司 PCB 业务重点拓展领域之一。公司以新能源和 ADAS 为主要聚焦方向，生产高频、HDI、刚挠、厚铜等产品，其中 ADAS 领域产品比重相对较高，主要集中于感知层、决策层领域，应用于摄像头、雷达等设备。

注：调研过程中公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。

附件清单	无
日期	2022 年 8 月 29 日